

关于XDG(LX)-2018-1号出让地块准入条件的函

无锡市国土资源局梁溪分局：

根据市政府办公室批转的“市国土资源局关于工业性项目等用地市场化运作的意见”和“市工业性项目用地招标采购挂牌出让实施细则”的要求，现复函如下：

XDG(LX)-2018-1号地块位于梁溪区金山北路与金山三支路交叉口东北侧，面积约6900平方米，用地性质为研发型工业用地，产业类型以物联网相关产业、塑料制品为主且符合无锡光电新材料科技园环保要求。亩均投资强度不低于350万，项目自供地之日起5年内年产税不低于50万元/亩。

无锡市梁溪区发展和改革局

2018年3月28日

